



2020년 5월 21일

브로드 파장 조사장치 「SPIR」의 판매개시

— 폭 넓은 파장으로 부품접착시의 경화시간 단축을 실현 —

우시오 전기 주식회사의 100% 자회사인 한국우시오 주식회사(본사:서울, 대표이사 사장 메카타 사토시)는 Spot UV 조사 장치 “Spot cure series”의 신라인업을 개발하여, 자외선(UV)으로부터 적외선(IR)까지의 폭넓은 파장(300~1000 nm)을 조사하는 것으로 전자 부품 접착시의 경화 시간 단축을 실현한 브로드파장 조사장치 “SPIR(에스피 아이알)”를 2020년 4월부터 판매 개시합니다.



φ 1~10mm 정도의 국소영역에 UV를 조사하는 Spot UV 조사기술은 전자업계나 자동차, 의료기기 등의 다양한 제조라인에서 경화, 접착, 봉지, 박리 등에 이용되고 있으며, 향후 스마트폰이나 자동차에 탑재되는 카메라의 증가에 따라 카메라모듈의 접착용도로의 Spot UV 조사수요가 증가할 것으로 알려져 있습니다. 게다가 최근, “빅 데이터” “IoT(Internet of Things)” 등의 첨단기술의 발전에 수반해, 자동차나 의료는 물론, 건설, 에너지, 농업 등 여러 가지 분야에도 센서를 시작으로 한 정밀 전자 부품이 보급될 것이 확실시되고 있습니다.

그러한 가운데, 시장에서는 생산성 향상의 요구가 높아지고 있어 이를 실현하기 위해서는 전자 부품 접착시의 경화 시간의 단축이 중요한 요소 중 하나가 되고 있습니다. 그러나 지금까지의 전자부품 제조공정에서는 부품 조립 후 항온조에 의한 1 시간 이상의 열수지 경화가 필요한 점, 또한 그 과정에서 부품의 열팽창에 의한 접착부의 왜곡이나 접착부에 이물질 부착 등의 문제가 발생하고 있는 과제가 있습니다.

이에 우시오는 UV 로부터 IR 까지의 폭넓은 파장을 동시에 또는 수지 소재나 용도에 따른 파장을 선택해 조사하는 것으로, 부품 조립 중에 고밀도로 수지를 경화하는 것과 동시에 항온조에 의한 불량품의 발생을 막아, “경화 시간의 단축”과 “수율 향상”을 실현한, 브로드 파장 조사장치를 판매합니다.

우시오는 앞으로도 각종 제조 프로세스의 요구에 “빛”으로 공헌해 갈 것입니다.

■주요 특징

① 단시간 열경화

종래 대비 1/3 의 경화시간을 실현

② 폭 넓은 파장

폭 넓은 파장에 의하여 여러 수지재료 및 용도에 맞춘 조사를 실현

③ 접착성 향상

장파장으로 접착수지의 깊은 곳까지 침투하고 보다 깊은 고밀도 경화를 실현

④ 다양한 어플리케이션에 대응

납땀이나 화장품 개발 등 열치환 반응을 이용하는 영역에서도 사용 가능

■ 사양

	SPIR (형식 : SPIR-220A)
크기	156(W) X 275 (D) X 250 (H)
중량	약 8.3k g
정격전압	AC100V ~ AC240V
소비전력	100V 입력시 3.8A 240V 입력시 1.6A
광원	프리 세트형 220W 램프
파장	300nm ~ 1000nm
자외선 강도	900mW/cm ² 이상 [조건] 폐사 파이버 SF-101NQ, 조사거리 50mm, 폐사 조도계: UVD-S405
피크 조도	950mW/cm ² 이상
램프 수명	공칭 2000 시간/초기조도 50%유지
셔터	모터식 셔터 탑재. 타이머/매뉴얼 제어 가능 타이머 설정 0.5 ~ 999 초 (0.1 초 스텝) 1000 ~ 9999 초 (1 초 스텝)
파이버/배선길이	약 1m
파이버 유닛	IR 전용 석영 파이버
분기수	1 개
렌즈 유닛	옵션

■본 건에 관한 문의 사항 및 화상 데이터의 청구에 대해서는, 아래 연락처로 문의 부탁드립니다:

한국우시오 주식회사(USHIO KOREA, INC.)
 TEL. 02-587-1115 FAX. 02-587-1118
 e-mail: uki_contact@ushio.co.kr
 http://www.ushio.co.kr